

## 에피택시 NiFe/Cu 다층박막의 구조 및 자기특성

청주대학교 물리학과 김 지영

장 평우

충북대학교 물리학과 최 태원

유 성초

### Structural and magnetic properties of epitaxial NiFe/Cu multi-layer

Dept. of Physics, Chongju University J. Y. Kim

P. W. Jang

Dept. of Physics, Chongju University J. Y. Kim

S. C. Yu

#### 1. 서론

Permalloy는 대표적인 연자성합금으로 벌크나 박막형태로 여러 분야에 이용되고 있다. 박막으로는 자기기록 헤드재료로 사용되어지는 것이 대표적인 것이며 기록용 inductive head나 read-용인 MR head에도 사용된다. Permalloy박막은 상온에서 박막으로 만들 경우 (111) 집합조직(또는 fiber texture)을 가지고 이 집합조직을 가질 경우 입자의 크기가 크고 또 연자기특성이 향상되는 것으로 알려져 있다. 최근에 Si(001)기판위에 Cu가 상온에서 에피택시성장한다는 것이 알려져 Fe/Pd/Cu 등의 형태로 다층 에피택시박막에 관한 연구가 진행되고 있다. Cu와 permalloy는 같은 면심입방구조를 가지고 격자상수도 각각 3.6148 Å, 3.5239 Å로 비슷해 2.5%정도 차이가 있으므로 에피택시성장을 한 다층박막을 제조할 수 있다. 에피택시 다층박막은 유리기판에서 성장한 입자에 비해 입자가 크고 결정 배향이 달라진다. 본 연구에서는 다층박막의 에피택시 성장을 통해 입자크기와 배향성이 자기적 특성에 미치는 영향을 조사하였다.

#### 2. 실험방법

Si(100)기판에 남아있는 기름을 제거한 후 이온교환수로 회석된 5%-HF로 에칭을 행하고 용액표면위로 천천히 기판을 꺼집어 내어(pull dried) 수소종단처리를 행한 후 최대한 빠른 시간 안에 기판을 진공조 안에 장착시켰다. 스파터하기 전  $3 \times 10^{-7}$  torr보다 좋은 진공도까지 도달한 후 예비스파터를 행하였다. 예비 스파터가 끝난 후 850 Å의 Cu층을 4인치의 Cu타겟으로부터 상온에서 Si(100)기판에 에피택시성장을 시킨 후 4 인치의 NiFe 타겟으로부터 20 Å을 에피택시 성장을 시킨다. 이후 20 Å NiFe/20 Å Cu층을 80 회 반복 증착하

였다. 비교를 위해 수소종단처리를 하지 않은 기판을 바로 옆에 위치시켜 스파터하였다.

이렇게 해서 만들어진 Fe박막은 통상의  $\theta$ - $2\theta$  스캔(Philips X'Pert)을 통해 결정학적 구조분석을 행하였으며 실험실에서 제작한 최대자장 10 kOe인 진동 시료형 자력계와 최대 자장 9 kOe인 토크자력계를 이용해 포화자화, 포화자장 그리고 이방성상수를 측정하였다. 또 수송특성을 알기 위해 박막의 자기저항을 측정하였다.

### 3. 실험 결과 및 고찰

그림 1은 수소종단처리를 한 경우와 하지 않은 기판에서 성장한 박막의 XRD패턴이다. 그림에서 수소종단처리를 하지 않은 기판에서 성장한 박막은 회절강도가 낮은 FCC의 (111) 패턴만 나타난다. 그러나 종단처리를 한 경우 (002)회절선의 강도가 매우 커 에피택시 성장이 촉진되었으나 (002) 회절선 외에 다른 회절선이 나타나므로 완벽하게 에피택시 성장이 일어나지 않았음을 알 수 있다. 구리의 (111)면의 회절각도는  $2\theta=43.29^\circ$ 이고 페말로이의 경우 약  $44.5^\circ$ 이지만 그림 1에서의 각도는 약  $43.8^\circ$ 정도이다. 이와 같이 구리와 페말로이의 회절선이 분리가 되지 않은 이유는 확실하지 않다. 또 그림 1에서  $32^\circ$ 와  $49^\circ$ 근처에 나타나는 회절선이 나타나는 이유 또한 확실하지 않고 현재 이 구조를 확인 중에 있다. 그림 2는 이 박막들의 VSM M-H 곡선을 나타낸 것으로 방향에 따라 큰 차이는 없다. 그러나 이 박막의 결정립의 크기가 달라 자기저항은 방향에 따라 크기가 달라질 것으로 예상되며 측정은 현재 진행중에 있다.

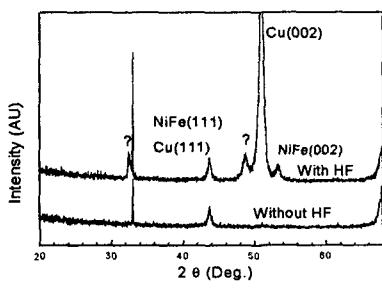


Fig. 1 X-ray diffraction pattern of NiFe/Cu multi-layer with and without H termination treatment.

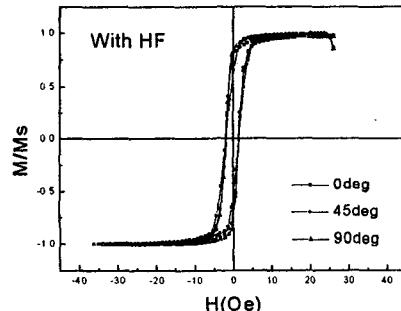


Fig. 2. VSM M-H loops of  $[NiFe/Cu]_n$  multi-layer.